

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2166)

**截至2026年6月30日止六個月之
中期業績**

財務摘要

- 本集團截至2026年6月30日止六個月的總收入為6,818.3百萬港元(2025年：2,796.2百萬港元)，較2025年同期增加143.8%。
- 本集團截至2026年6月30日止六個月的毛利為408.9百萬港元(2025年：162.2百萬港元)，較2025年同期增加152.0%。
- 截至2026年6月30日止六個月，本公司擁有人應佔淨利潤為290.0百萬港元(2025年：48.5百萬港元)，較2025年同期增加498.4%。
- 截至2026年6月30日止六個月，每股基本及攤薄盈利分別為63.35港仙(2025年：10.44港仙)及62.59港仙(2025年：10.38港仙)。
- 董事會決議宣派截至2026年6月30日止六個月的中期股息每股5港仙(截至2025年6月30日止六個月：每股3港仙)。

中期業績

芯智控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」或「我們」)截至2026年6月30日止六個月(「報告期間」)的未經審核簡明綜合業績連同2025年同期之比較數字。該等業績以報告期間的簡明綜合財務報表(其根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則第34號中期財務報告(「香港會計準則第34號」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的適用披露條文規定編製)為基準。

本公司核數師羅申美會計師事務所已根據香港會計師公會發佈之香港審閱委聘準則第2410號「由實體獨立核數師審閱中期財務資料」審閱未經審核中期財務資料。

簡明綜合財務報表

簡明綜合損益表

截至2026年6月30日止六個月

		截至6月30日止六個月	
		2026年	2025年
		千港元	千港元
		(未經審核)	(未經審核)
附註			
收入	4	6,818,258	2,796,194
銷售成本		(6,409,348)	(2,633,954)
毛利		408,910	162,240
其他收入		12,966	11,236
其他收益或(虧損)淨額		2,533	534
貿易應收款項減值虧損撥回／(減值虧損)		1,120	(1,913)
研發費用		(19,670)	(17,757)
行政費用		(45,782)	(36,370)
銷售及分銷費用		(87,052)	(57,071)
應佔聯營公司業績		87,045	7,668
財務費用		(30,591)	(13,001)
除稅前利潤		329,479	55,566
所得稅費用	5	(40,097)	(7,003)
期間利潤	6	289,382	48,563
以下人士應佔：			
本公司擁有人		289,973	48,458
非控股權益		(591)	105
		289,382	48,563
每股盈利	8		
基本		63.35 港仙	10.44 港仙
攤薄		62.59 港仙	10.38 港仙

簡明綜合財務報表

簡明綜合損益及其他全面收入表 截至2026年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
期間利潤	<u>289,382</u>	<u>48,563</u>
其他全面收入：		
其後可能重新分類至損益的項目：		
換算海外業務產生的匯兌差額	<u>9,255</u>	<u>5,712</u>
期間其他全面收入(扣除稅項)	<u>9,255</u>	<u>5,712</u>
期間全面收入總額	<u><u>298,637</u></u>	<u><u>54,275</u></u>
以下人士應佔：		
本公司擁有人	299,196	54,136
非控股權益	<u>(559)</u>	<u>139</u>
	<u><u>298,637</u></u>	<u><u>54,275</u></u>

簡明綜合財務報表

簡明綜合財務狀況表

於2026年6月30日

		2026年 6月30日 千港元 (未經審核)	2025年 12月31日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		4,232	4,579
使用權資產		31,292	36,051
商譽		20,159	20,159
無形資產		7,115	11,097
會所債券		6,005	5,960
透過其他全面收入按公平值列賬 之金融資產		43,043	41,786
透過損益按公平值列賬之金融資產		175,127	148,144
於聯營公司之投資		239,630	150,890
按金		5,458	4,350
遞延稅項資產		12,700	2,279
		544,761	425,295
流動資產			
存貨		1,027,027	292,340
貿易應收款項及應收票據	9	1,821,592	1,173,903
預付款項、按金及其他應收款項		147,425	35,919
已抵押銀行存款		288,594	182,684
銀行及現金結餘		165,652	153,960
		3,450,290	1,838,806
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	10	1,158,875	494,193
合約負債		14,067	26,829
應付聯營公司款項		1,477	4,920
其他應付款項及應計費用		148,957	84,730
租賃負債		7,330	10,060
銀行及其他借貸	11	1,270,599	529,872
即期稅項負債		61,859	22,084
		2,663,164	1,172,688

	附註	2026年 6月30日 千港元 (未經審核)	2025年 12月31日 千港元 (經審核)
流動資產淨值		<u>787,126</u>	<u>666,118</u>
總資產減流動負債		<u>1,331,887</u>	<u>1,091,413</u>
非流動負債			
租賃負債		24,725	27,031
銀行及其他借貸	11	<u>—</u>	<u>1,396</u>
		<u>24,725</u>	<u>28,427</u>
資產淨值		<u><u>1,307,162</u></u>	<u><u>1,062,986</u></u>
資本及儲備			
股本		38	38
儲備		<u>1,306,045</u>	<u>1,061,016</u>
本公司擁有人應佔權益		1,306,083	1,061,054
非控股權益		<u>1,079</u>	<u>1,932</u>
權益總計		<u><u>1,307,162</u></u>	<u><u>1,062,986</u></u>

簡明綜合財務報表附註

截至2026年6月30日止六個月

1. 編製基準

該等簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的適用披露規定編製。

該等簡明綜合財務報表須連同2025年度財務報表一併閱讀。編製該等簡明綜合財務報表所用的會計政策(包括管理層就應用本集團會計政策作出的重大判斷及估計不確定因素的主要來源)及計算方式與截至2025年12月31日止年度的年度財務報表所用者一致。

2. 新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則

本集團採納的新訂及經修訂準則

本集團已自2026年1月1日起首次採納香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號(修訂本)——金融工具的分類與計量以及香港財務報告準則會計準則之年度改進——第11冊。本集團並未因採納上述經修訂準則而改變其會計政策或作出追溯性調整。

3. 分部資料

主要營運決策者已確定為本公司的董事。為分配資源及評估分部業績，董事審閱本集團集中於所交付貨品類別之內部報告。本集團已識別的兩個可報告分部如下：

(a) 授權分銷

(b) 混合分銷

於達致本集團的可報告分部時，概無合併計算任何經營分部。

經營分部的會計政策與本集團截至2025年12月31日止年度的年度綜合財務報表附註4所述的本集團的會計政策相同。分部利潤指各分部賺取的利潤，而並無分配未分配費用、應佔聯營公司業績、透過損益按公平值列賬之金融資產之公平值收益及加密貨幣減值虧損。此乃向董事呈報以分配資源及評估表現之衡量基準。

董事按各分部的經營業績作出決定。由於董事並無就分配資源及表現評估定期審閱分部資產及分部負債，故並無呈列有關資料分析。因此，僅呈列分部收益及分部業績。

可報告分部損益的資料：

	授權分銷 千港元	混合分銷 千港元	分部總計 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
截至2026年6月30止六個月(未經審核)					
來自外部客戶的收入	6,714,360	103,898	6,818,258	–	6,818,258
分部間銷售*	<u>4,593</u>	<u>23,062</u>	<u>27,655</u>	<u>(27,655)</u>	<u>–</u>
	<u>6,718,953</u>	<u>126,960</u>	<u>6,845,913</u>	<u>(27,655)</u>	<u>6,818,258</u>
分部利潤	<u>209,862</u>	<u>6,430</u>	<u>216,292</u>	<u>–</u>	<u>216,292</u>
截至2025年6月30止六個月(未經審核)					
來自外部客戶的收入	2,754,011	42,183	2,796,194	–	2,796,194
分部間銷售*	<u>2,417</u>	<u>3,942</u>	<u>6,359</u>	<u>(6,359)</u>	<u>–</u>
	<u>2,756,428</u>	<u>46,125</u>	<u>2,802,553</u>	<u>(6,359)</u>	<u>2,796,194</u>
分部利潤	<u>40,657</u>	<u>5,328</u>	<u>45,985</u>	<u>–</u>	<u>45,985</u>

* 分部間銷售按成本收取

可報告分部損益的對賬：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
損益		
可報告分部總利潤	216,292	45,985
未分配金額：		
未分配費用	(11,558)	(6,648)
透過損益按公平值列賬之金融資產之公平值收益	796	1,558
應佔聯營公司業績	87,045	7,668
加密貨幣減值虧損	(3,193)	—
期間綜合利潤	289,382	48,563

地區資料：

本集團主要在香港、中國、新加坡及日本經營業務。

下表載列本集團按地區市場(基於相關集團實體成立所在的司法權區，亦即其於本期間的經營地點，不分貨品來源及客戶地理位置)劃分的銷售額分析。

來自外部客戶的收入(基於相關集團實體的經營地點)

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
香港	2,744,565	1,432,163
中國	2,265,224	941,204
新加坡	1,770,133	414,791
日本	451	506
其他	37,885	7,530
綜合總計	6,818,258	2,796,194

4. 收入

(a) 來自客戶合約的收入分拆

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
貨品或服務類別		
銷售電子元器件	<u>6,818,258</u>	<u>2,796,194</u>
收入確認時間		
按即時確認	<u>6,818,258</u>	<u>2,796,194</u>
銷售渠道／產品線		
授權分銷		
— 智能終端	2,558,724	1,895,596
— 存儲	3,661,321	553,555
— 算力基建	<u>494,315</u>	<u>304,860</u>
	6,714,360	2,754,011
混合分銷	<u>103,898</u>	<u>42,183</u>
	<u>6,818,258</u>	<u>2,796,194</u>

(b) 來自客戶合約的履約責任

銷售電子元器件於貨品的控制權轉移，即貨品交付至銷售協議所訂明之交貨港口或客戶指定地點時確認。交貨完成後，客戶承擔貨品報廢及損失的風險。

根據銷售合約條款收取的預付款項及本集團收取的任何交易價格確認為合約負債，直至貨品交付予客戶為止。一般信貸期為交貨後0至120天。

於2026年6月30日及2025年12月31日，所有尚未履行的銷售合約預期將於報告期末後12個月內獲履約。

5. 所得稅費用

截至6月30日止六個月	
2026年	2025年
千港元	千港元
(未經審核)	(未經審核)
即期稅項	
香港利得稅	32,932
中國企業所得稅(「中國企業所得稅」)	6,282
新加坡企業所得稅(「新加坡企業所得稅」)	10,553
其他	353
	5,960
	953
遞延稅項	50,398
	7,385
	(10,301)
	(382)
	40,097
	7,003

6. 期間利潤

本集團期間利潤已扣除：

截至6月30日止六個月	
2026年	2025年
千港元	千港元
(未經審核)	(未經審核)
員工成本(包括董事酬金)	
薪金、工資及其他津貼	43,014
酌情花紅	36,143
退休福利計劃供款	35,365
	19,478
	7,903
員工成本總額	86,282
	62,050
無形資產攤銷(計入銷售及分銷費用)	790
物業、廠房及設備折舊	790
使用權資產折舊	1,025
1,176	4,422
4,577	6,347,488
2,624,272	61,860
9,682	

7. 股息

於本中期期間，本公司擁有人獲宣派及派付截至2025年12月31日止年度的末期股息每股14港仙(2025年：截至2024年12月31日止年度為每股10港仙)。於中期期間宣派及派付的末期股息總額為63,801,000港元(2025年：46,109,000港元)。

於本中期期間結束後，本公司董事決定中期股息為每股5港仙(2025年：3港仙)，總額為29,321,000港元(2025年：14,660,000港元)。

8. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃按以下數據計算：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
盈利		
就計算每股基本及攤薄盈利而言的盈利	<u>289,973</u>	<u>48,458</u>
股份數目		
就計算每股基本盈利而言的普通股加權平均數	457,714,080	464,017,770
受限制股份單位(「受限制股份單位」)產生的 潛在攤薄普通股之影響	<u>5,599,616</u>	<u>2,972,376</u>
就計算每股攤薄盈利而言的普通股加權平均數	<u>463,313,696</u>	<u>466,990,146</u>

截至2026及2025年6月30日止六個月，就計算每股基本盈利而言的普通股加權平均數，已計及受託人就未歸屬獎勵股份及未授出股份而根據本公司股份獎勵計劃自市場購入的普通股(經根據本公司股份獎勵計劃歸屬的普通股調整)。

本公司擁有人應佔每股基本盈利乃按期內本公司擁有人應佔溢利除以年內已發行普通股加權平均數計算。

9. 貿易應收款項及應收票據

本集團與客戶的貿易條款主要為信貸條款。信貸期一般介乎0至120天(2025年12月31日：0至120天)。應收票據的一般到期期限介乎30至180天(2025年12月31日：30至180天)。本集團力求嚴格監控其未收回應收款項。逾期結餘由董事定期審閱。

於報告期末，貿易應收款項按各自發票逾期日期呈列的賬齡分析(扣除信貸虧損撥備)及應收票據按票據發行日期呈列的賬齡分析(扣除信貸虧損撥備)如下：

	2026年 6月30日 千港元 (未經審核)	2025年 12月31日 千港元 (經審核)
貿易應收款項：		
未逾期	1,746,687	1,074,049
0-60天	59,935	79,259
61-120天	565	649
	<u>1,807,187</u>	<u>1,153,957</u>
應收票據		
0-60天	<u>14,405</u>	<u>19,946</u>

於2026年6月30日，本集團與金融機構訂立若干應收款項購買協議，就指定客戶應付的貿易應收款項進行保理，該等貿易應收款項的賬面總值為759,950,000港元。本公司董事認為，該等應收款項應根據香港財務報告準則第9號全面終止確認。

於2026年6月30日，除應收票據14,405,000港元(2025年12月31日：19,946,000港元)外，本集團並無就貿易應收款項的賬面值持有任何抵押品或其他信貸增強保障，亦無合法權利可用於抵銷本集團結欠交易對方的任何款項。

10. 貿易應付款項及應付票據

貿易應付款項的信貸期介乎0至60天(2025年12月31日：0至60天)。

本集團貿易應付款項及應付票據按發票日期呈列的賬齡分析如下：

	2026年 6月30日 千港元 (未經審核)	2025年 12月31日 千港元 (經審核)
0-30天	1,099,883	467,423
31-60天	42,861	19,920
61-90天	1,674	2,813
超過90天	14,457	4,037
	<u>1,158,875</u>	<u>494,193</u>

11. 銀行及其他借貸

	2026年 6月30日 千港元 (未經審核)	2025年 12月31日 千港元 (經審核)
有抵押銀行貸款	758,531	331,002
有抵押銀行貸款—供應商融資安排	512,068	200,266
	<u>1,270,599</u>	<u>531,268</u>

銀行及其他借貸須於以下時間償還：

	2026年 6月30日 千港元 (未經審核)	2025年 12月31日 千港元 (經審核)
一年內	666,883	90,823
超過一年但不超過兩年	—	814
超過兩年但不超過五年	—	582
	<u>666,883</u>	<u>92,219</u>
含有按要求償還條款的部分銀行及其他借貸 (於流動負債項下列示)	<u>603,716</u>	<u>439,049</u>
	<u>1,270,599</u>	<u>531,268</u>
減：於12個月內結算的款項(於流動負債項下列示)	<u>(1,270,599)</u>	<u>(529,872)</u>
	<u>—</u>	<u>1,396</u>

中期股息

董事會決議宣派截至2026年6月30日止六個月的中期股息每股5港仙(截至2025年6月30日止六個月：每股3港仙)，預計將於2026年9月25日(星期五)或前後支付予於2026年9月16日(星期三)名列本公司股東名冊的本公司股東(「股東」)。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2026年9月14日(星期一)至2026年9月16日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間將不辦理股份過戶登記手續。為合資格獲得中期股息，所有過戶文件連同有關股票須於不遲於2026年9月11日(星期五)下午4時30分交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)進行登記。

管理層討論及分析

業務回顧

一、全球經濟：低增長、高分化，風險與韌性並存

2026年上半年，地緣衝突推動能源與商品價格上行，導致全球經濟顯著分化。國際貨幣基金組織(IMF)最新報告預計全球經濟年增速放緩至3.0%，通脹預測上調至4.7%。聯合國給出更為審慎的2.7%預估值，顯著低於疫情前3.2%的平均水平。兩大機構均認為「低增長、高分化」是宏觀底色，地緣衝突、貿易碎片化及AI估值泡沫破裂風險是主要隱憂。

世界貿易組織(WTO)預計全球商品貿易量增速從4.6%降至1.9%，傳統商品貿易疲軟，但是AI相關商品(芯片、伺服器、光模組)貿易強勁，AI軟件與雲服務跨境輸出成為新增量。產業投資方面，地緣博弈與貿易壁壘延緩全球直接投資復甦，供應鏈加速向東南亞、墨西哥、印度多元化佈局，短期推高資本支出15%–25%，但中長期或因效率損失導致盈利下降。全球製造業已從「效率最優」轉向「效率、安全與韌性」三重目標的動態平衡，彈性供應鏈成為核心戰略，有利於電子元器件混合分銷模式發展。

中國經濟方面，上半年GDP同比增長4.7%，高技術製造業增長13.3%，集成電路產量增長23.1%，遠超工業平均的5.4%增速。外貿進出口同比增長16.9%達25.47萬億元，貿易順差收窄4.7%。其中集成電路出口額1,772.8億美元，同比增長達96.1%，穩居第一大出口商品。值得注意的是，集成電路出口金額近乎倍增，但出口量僅增長約7%，表明本輪增長主要是由芯片價格上漲驅動。而且存儲芯片佔到出口額約65%。

二、半導體產業：AI驅動全球半導體邁入萬億美元新紀元

2026年，全球半導體產業將邁入萬億美元級新紀元，AI算力需求成為核心驅動引擎。世界半導體貿易統計協會(WSTS)於6月發佈的春季預測大幅上調展望：預計全年市場規模將突破1.5萬億美元，其中存儲芯片營收將從2025年的2,300億美元躍升至8,039億美元，同比大增249.5%；邏輯芯片同比增長超30%。美國半導體行業協會(SIA)的月度統計資料印證了這一發展態勢，一季度全球半導體市場銷售額同比增長79.2%達2,985億美元。

半導體產業增長的驅動力呈現前所未有的結構性分化：AI伺服器對HBM(高頻寬記憶體)、企業級eSSD、GPU及高速互聯芯片的強勁需求構成主要引擎。智能手機、PC等傳統市場則受制於存儲價格上漲，出貨量下滑。市場調研機構IDC資料顯示，今年二季度全球PC出貨量同比下降4.9%，全年預計同比下降11.3%。本輪增長主要源自平均售價(ASP)提升而非出貨量擴張。統計資料顯示，若剔除AI相關領域的貢獻，傳統半導體芯片市場增長空間有限。

三、集團的業務表現

2026年上半年，集團圍繞AI科技主線持續深化業務佈局，以存儲芯片、智能終端、算力基建及混合分銷四大業務單元協同發力。得益於存儲芯片業務的爆發式增長，集團整體業績實現跨越式提升，各業務單元均實現同比大幅增長。其中，存儲芯片業務單元表現突出，在集團營收中的佔比快速提升。這一變化深刻體現了AI對產業格局的重塑力量，也驗證了集團「多賽道佈局、重點突破」戰略的前瞻性與有效性。各業務單元的半年度回顧如下：

3.1 存儲業務單元

本集團在存儲領域深耕多年，已形成覆蓋DRAM、NAND快閃記憶體、NOR快閃記憶體、MCP、KGD以及eSSD模組等多品類的存儲芯片產品矩陣，能夠滿足從端側可穿戴設備、智能終端到雲端數據中心等各類應用場景。

2026年上半年，全球存儲芯片市場正處於由AI需求推動的歷史性「超級週期」中。市場研究機構集邦諮詢(TrendForce)於5月發佈的預測報告顯示，AI發展從大型模型訓練轉向以推理為核心的代理式AI應用，驅動存儲器需求結構性擴張。該機構將2026年全球存儲器產值從年初預計的5,516億美元大幅上修至8,893億美元，2027年則進一步上修至逾1.28萬億美元。這意味著存儲芯片將成為半導體產業史上增長最快的單一品類。

資料顯示，單台AI伺服器對DRAM的容量需求約為傳統伺服器的8倍，NAND快閃記憶體容量需求約為3倍，且大量採用價值量極高的HBM和eSSD等高階產品。由於製造相同容量的HBM需消耗相當於普通DRAM芯片3-4倍的晶圓產能，頭部存儲廠商將產能優先配置給更高利潤的HBM，嚴重擠佔了傳統DRAM的供給，導致DRAM芯片價格出現持續攀升。TrendForce的資料顯示，2026年第二季度常規DRAM合約價格環比上漲58-63%，NAND快閃記憶體合約價格環比上漲70-75%，預計第三季度分別再漲13-18%和10-15%。

與此同時，AI Agent技術的快速演進和在應用端落地，百萬Token上下文推理和智能體應用普及，帶來的Token消耗量將是普通Chat交互的10-50倍，顯著拉動了HBM、DRAM和企業級eSSD的需求。

為支援端側AI設備本地大模型推理，智能手機、PC等終端開始配備更高容量的LPDDR5X和UFS 4.0嵌入式存儲。主流AI眼鏡普遍採用2GB DRAM與32GB NAND快閃記憶體的存儲組合，高端型號則容量更大。而且AI硬件憑藉創新性功能帶來的高溢價，能更好消化存儲用量增長帶來的成本上升，在獲取供應鏈資源時具備更強的溢價能力，推動存儲芯片價格漲價。

2026年上半年，本業務單元與多家全球知名存儲芯片原廠保持緊密的業務合作，成功把握存儲芯片超級週期機遇，實現業績跨越式增長。2026年上半年累計實現銷售額3,661.3百萬港元，同比大幅增長561.4%，帶動集團整體營收規模躍升至新台階。

3.2 智能終端業務單元

SoC (System on Chip)作為電子產品的中樞控制核心，其技術演進正加速向集成NPU (Neural Processing Unit)的方向發展，以滿足端側低延遲、高能效條件下的本地AI計算需求。各SoC廠商紛紛推出集成高性能NPU的新一代技術平台，不僅支援端側AI的推理加速，更在圖像信號處理(ISP)、音頻處理和感測器融合等維度實現技術升級，推動語音交互、即時翻譯、圖像識別、圖像生成等創新應用的普及。尤其是在AI PC、智能穿戴、工業視覺和機器人等高算力需求領域，呈現出強勁的增長勢頭。

IDC在4月發佈的報告指出，2026年全球AI PC出貨量預計達到1.23億台，佔全部PC出貨量的45%以上；智能手機端側AI芯片滲透率也在快速攀升，預計2027年全球超過70%的智能手機都將搭載AI引擎。AI SoC的市場需求正在快速攀升，據Semiconductor Insight發佈的報告，2026年全球AI SoC市場規模預計為412.3億美元，到2034年將增長至1,037.3億美元，CAGR約為14.6%。Grand View Research的報告顯示，2026年全球邊緣AI市場規模約為300億美元，預計到2033年將增至1,187億美元，CAGR達到21.7%。Forrester的研究指出，企業將模型推理從雲端遷移到邊緣設備可降低40–70%的AI運營支出，這為端側AI SoC市場的長期增長提供了堅實的經濟學基礎。

綜合來看，AI SoC驅動的端側智能浪潮正在開啟半導體產業新一輪增長週期，並將重塑電子產品形態未來的競爭格局。本業務單元與業內多家知名SoC芯片原廠保持緊密合作，為客戶提供涵蓋芯片供應鏈保障、定製化技術解決方案及全週期的FAE技術支援。2026年上半年，得益於AI SoC市場的快速擴張及公司在新興賽道的持續深耕，本業務單元累計實現銷售額2,558.7百萬港元，同比大幅增長35.0%，表現出強勁的市場競爭力與業務韌性。

3.3 算力基建業務單元

本業務單元聚焦算力基礎設施領域的光通信核心器件，核心產品涵蓋應用於200G/400G/800G/1.6T高速數通光模組的發射芯片(CWLD、VCSEL、EML等)及接收芯片(PD、APD等)。高性能收發芯片是光模組中技術含量最高的核心環節。隨著光模組速率從400G向800G乃至1.6T躍遷，對光收發芯片的性能要求呈指數級提升。

全球AI算力基礎設施投資與數據中心高速傳輸需求持續加碼，推動光模組市場進入結構性增長新階段。據TrendForce集邦諮詢於2026年5月發佈的研究報告，全球前九大雲服務供應商(CSP) 2026年資本支出總額預測已上調至約8,300億美元，同比增長79%，反映AI算力基建投資仍處於加速升溫階段。

本業務單元依託與全球領先光通信芯片原廠的深度合作，結合集團光模組領域的優質客戶資源，上半年累計實現銷售額494.3百萬港元，同比增長62.1%，業務發展勢頭良好。

3.4 混合分銷業務單元

獨立分銷是電子元器件供應鏈中由市場機制驅動的去中心化網路，整合原廠、OEM/CEM過剩庫存及同業渠道，服務於緊急現貨、EOL批量採購及停產物料調配，在供需失衡時保障製造商的生產連續性。Research Nester預測，2025年全球電子元器件分銷市場規模約2,007億美元，至2035年將達3,912億美元，CAGR 7.7%。

2026年上半年，存儲芯片及晶圓嚴重短缺、交期超長，製造企業紛紛轉向獨立分銷尋現貨，推動本業務單元需求增長。我們依託集團供應鏈整合能力，快速匹配緊缺物料，並在功率器件、國產EDA軟件等領域為客戶推薦可替換AVL的原廠資源，實現從「解決缺貨」到「替換引導」的混合分銷獨特銷售模式。行業趨勢方面，日趨嚴格的國際貿易合規要求正重塑准入門檻，供應鏈透明度與可追溯性成為客戶核心考量，利好具備規範運作能力的中大型分銷商。

上半年，本業務單元受益於市場對供應鏈彈性的迫切需求，客戶數與訂單額明顯回升，累計實現銷售額103.9百萬港元，同比增長146.3%。

展望

一、宏觀經濟展望

2026年下半年，全球經濟仍處在不確定性的結構調整中。經合組織(OECD)預計今年全球GDP增速將從2025年的3.4%放緩至2.8%，2027年回升至3.1%；世界銀行(WB)的增速預測值僅為2.5%，並且全球約三分之二的經濟體增速遭到下調，中東能源衝擊、貿易碎片化及AI估值修正是主要風險。中國經濟方面，世界銀行7月預計中國全年經濟增長為4.4%，亞洲開發銀行則維持之前4.6%的預測值，其中高技術投資與強勁的出口是核心支撐，電子資訊製造業在AI驅動下將繼續保持全球競爭力。

二、半導體市場展望

全球半導體市場預計將繼續維持高景氣度，除了WSTS提供的樂觀預測數據，Gartner在4月將2026年全球半導體收入預測上調至超1.3萬億美元，同比增長64%，創下近二十年的最高增速，此外Omdia也同步上調增速至62.7%。調研機構普遍認為HBM擠佔常規DRAM產能導致存儲供給緊張，實質性緩解需等到2027年下半年，預計DRAM價格2026年的累計漲幅將達125%。

產業的短期統計數據也印證高景氣，SIA統計的數據顯示，今年5月全球半導體芯片銷售額達1,206.1億美元，相比去年同期實現倍增，並連續第31個月實現同比增長，增長的核心驅動力仍然來自AI。此外，端側AI設備開始進入全面普及窗口，雲端與端側共振將驅動市場邁向更大的規模。

基於上述宏觀經濟與產業趨勢研判，我們對各業務單元展望如下：

3.1 存儲業務單元：AI超級週期延續，結構性景氣持續

展望2026年下半年，全球存儲芯片市場的高景氣週期仍將持續。TrendForce在6月發佈的報告中指出，在HBM產能持續擠佔常規DRAM供應的背景下，2026年全年DRAM位元供給增長率預計僅為16%左右，遠低於歷史年均25%以上的增速水平，市場結構性緊缺的供給格局短期內難以緩解。該機構預計存儲價格將在2026年下半年觸及本輪週期峰值，隨後進入高位盤整階段，年內出現大幅回檔的可能性較低。

值得關注的是，AI Agent技術的成熟正在開闢存儲需求的「第二增長曲線」。具備百萬級Token長期記憶和自主決策能力的AI Agent，其推理過程中的數據吞吐量遠超傳統應用，對HBM和eSSD存儲容量的需求呈非線性增長。TrendForce已於2026年5月將2027年全球存儲器產值預測由8,427億美元大幅上調至超過1.28萬億美元，年增率約44%。基於集團在存儲市場多年來的深厚佈局，以及上半年通過核心大客戶合作建立起的規模化供應能力，本業務單元對下半年的業務成長持樂觀態度。

3.2 智能終端業務單元：AI SoC引領端側智能全面普及

隨著AI從雲端計算向物理世界加速滲透，端側AI正從「錦上添花」變為「不可或缺」。端側AI化的驅動力來自多個維度：7B參數級模型已可在智能手機和PC上流暢運行且性能持續提升；商業級應用對敏感數據安全性的高度重視使端側推理確保數據「不出設備」；Agent時代Token消耗呈指數級增長，疊加雲端API調用成本上升，推動用戶部署本地算力以控制成本。目前，本地硬件已可高效實現語音辨識、圖像生成、智能助手等AI功能，這一趨勢的核心在於AI SoC在技術架構與能效比上的持續迭代創新。Semiconductor Insight在2026年3月發佈的報告顯示，AI SoC市場2026年將達412.3億美元規模，2026至2034年期間的複合年增長率約為14.6%。

2026年將是AI智能終端從「少數人的嘗鮮品」變為「多數人的標配」的關鍵一年，具備AI能力的智能終端產品憑藉較高的產品溢價能力，有望以遠超傳統電子產品的增速成為驅動消費電子市場結構性變革的核心力量。

展望2026年下半年，隨著AI PC和AI手機的加速普及（IDC預測AI PC年度出貨量將超1.23億台、佔據PC市場45%以上份額），消費者對內置AI處理能力的智能設備需求將持續攀升。與此同時，AI眼鏡、AI耳機等新興智能穿戴品類正在快速打開市場，AI攝像頭、掃地機器人、具身智能等AI視覺應用場景加速滲透，將進一步擴大對AI SoC芯片的需求基數。本業務單元將聚焦智能穿戴、智慧視覺、機器人等高增長賽道，把握端側AI全面普及的歷史機遇。

3.3 算力基建業務單元：持續受益於AI基礎設施投資浪潮

展望2026年下半年，全球AI算力基礎設施投資將繼續保持高速增長，以AI伺服器 and 光模組為核心採購標的的算力基建投資佔比持續提升，表明全球科技巨頭在AI算力領域的投入正在全面加速，對高速光模組的需求增速有望超出此前市場預期。據LightCounting預測，2026年800G光模組出貨量將實現翻倍以上增長，1.6T光模組進入規模量產元年，其芯片組銷售額有望首次突破20億美元，並於2029年前保持快速增長態勢。

隨著AI大模型參數規模持續擴大及訓練集群向「十萬卡」乃至「百萬卡」級別演進，且光互連逐步取代銅互連，光模組的增速已超過xPU(算力芯片)的增長速度，將進一步放大光模組的市場需求總量。Yole Group的報告顯示，全球光模組市場規模預計將從2025年的234億美元增長至2031年的1,123億美元，年複合增長率達到30%。在此背景下，本業務單元將持續深化與全球領先光通信芯片原廠的戰略合作，積極拓展國內外優質客戶資源，充分把握算力基建高速發展的戰略機遇。

3.4 混合分銷業務單元：傳統模式迎來AI賦能與合規升級新機遇

全球電子元器件供應鏈正經歷深層次的結構性調整，供需錯配與交期波動已從短期擾動演變為結構性常態。製造企業在常規授權渠道之外，對獨立分銷渠道的依賴度持續上升。AI技術在需求預測、庫存優化和風險預警等供應鏈管理環節的應用日趨成熟，正重塑分銷行業的運營模式和服務標準。此外，國際貿易合規要求的持續趨嚴將加速行業洗牌，有利於具備規範運作能力和完善合規體系的中大型分銷商擴大市場份額。隨著全球半導體市場規模突破萬億美元級別，電子元器件分銷行業的總量天花板將被大幅抬升，混合分銷模式的成長空間也相應拓寬。

本業務單元將通過AI化運營升級、強化合規管理體系、拓展全球業務網路三大舉措，在複雜多變的市場環境中確立差異化競爭優勢，持續為客戶創造價值，實現可持續發展。

四、小 結

人工智能作為最具變革性的通用目的技術，正深刻重塑全球產業發展格局。其對先進算力、高速存儲和低延遲傳輸的剛性需求，使得人工智能與先進半導體之間形成了深度耦合的共生關係。正是這種強勁的需求驅動，多家權威調研機構相繼大幅上調了半導體市場規模的增長預期——麥肯錫年初發佈的報告便指出，僅人工智能與數據中心兩大領域，就足以推動半導體行業在2030年前突破萬億美元大關。而當前市場的實際增速，已顯著超出其基準假設，這標誌著半導體行業正步入由人工智能驅動的超級繁榮週期。

然而，繁榮之中亦潛藏著變數。一方面，若HBM產能擴張快於預期，或AI資本開支增速意外放緩，存儲芯片價格便可能提前見頂；另一方面，端側AI的殺手級應用迄今尚未完全成熟，消費者換機意願也可能低於預期。這些不確定性，為行業的長期增長路徑增添了值得持續關注的隱憂。

綜上所述，2026年上半年，存儲芯片業務的爆發式增長帶動集團營收規模躍升至全新量級，成為發展歷程中的重要里程碑。與此同時，智能終端、算力基建與混合分銷三大業務單元亦實現同比大幅增長，不僅印證了集團在AI全產業鏈佈局中的均衡性與戰略前瞻性，更充分驗證了「多賽道佈局、重點突破」這一策略的有效性。展望未來，集團將依託授權分銷、獨立分銷、技術增值服務及光通信芯片等環節的全鏈條優勢，進一步深化與產業鏈上下游的戰略協同；持續深耕AI軟硬件領域，積極拓展國內外業務網絡，借助AI智能化轉型構建更具韌性的全球化供應鏈服務體系。在穩健經營與創新驅動並重的前提下，集團將不斷提升業務質量與盈利水平，致力於為股東創造更長遠、更豐厚的價值回報。

財務回顧

收入

截至2026年6月30日止六個月，本集團收入為6,818.3百萬港元，較2025年同期(2,796.2百萬港元)增加4,022.1百萬港元(143.8%)。收入增加主要由於存儲及端側AI SoC的銷售額增加。

毛利

截至2026年6月30日止六個月，我們的毛利較2025年同期(162.2百萬港元)增加246.7百萬港元(152.0%)至408.9百萬港元。截至2026年6月30日止六個月，我們的毛利率增加0.2%至6.0%(截至2025年6月30日止六個月：5.8%)。毛利率增加主要是由於智能終端及算力基建業務單元的銷售額及毛利率增加所致。

研發費用

研發費用主要包括我們的研發部門所產生的員工成本。截至2026年6月30日止六個月，研發費用為19.7百萬港元，較截至2025年6月30日止六個月(17.8百萬港元)增加10.8%。該增加主要由於我們研發人員的員工成本增加所致。

行政、銷售及分銷費用

截至2026年6月30日止六個月，行政、銷售及分銷費用合共為132.8百萬港元(截至2025年6月30日止六個月：93.4百萬港元)，佔截至2026年6月30日止六個月收入的1.9%，而2025年同期則為3.3%。該增加主要由於我們銷售及分銷人員的員工成本增加所致。

財務費用

截至2026年6月30日止六個月，本集團之財務費用為30.6百萬港元(截至2025年6月30日止六個月：13.0百萬港元)。本集團與主要往來銀行訂立多項融資安排。財務費用同比有所增加，此主要由於用於本集團業務的銀行及其他借貸增加所致。

期間利潤

截至2026年6月30日止六個月，本集團利潤為289.4百萬港元，較2025年同期的48.6百萬港元增加240.8百萬港元，增幅為495.9%。截至2026年6月30日止六個月的純利率約為4.2%，較2025年同期(2025年：1.7%)增加2.5%。

本公司擁有人應佔淨利潤

截至2026年6月30日止六個月，本公司擁有人應佔淨利潤為290.0百萬港元(截至2025年6月30日止六個月：48.5百萬港元)，較2025年同期增加498.4%。

全球發售所得款項用途

本公司股份於2016年10月7日在聯交所上市(「上市」)。本公司按每股股份1.83港元發行125,000,000股面值為0.00001美元的新股份。經扣除有關上市之承銷費用及估計開支後，本公司所收取之來自上市的所得款項淨額為約205.8百萬港元。

於2025年12月17日，董事會議決變更上市所籌集所得款項淨額23.9百萬港元的用途。未動用所得款項原先擬用於升級、進一步發展及維護本集團的電商平台以及改良技術基礎設施。鑑於本集團電商平台的當前發展水平已足以達成及維持該主要目的，董事會議決將未動用所得款項中約8.4百萬港元用於與銷售AI相關電子元器件相關的營銷及營運開支，以及爭取AI相關電子元器件的額外分銷授權，而約15.5百萬港元將用於招聘研發人員，以提供技術支援及解決方案服務，輔助本集團分銷AI相關電子元器件業務。詳情請參閱本公司日期為2025年12月17日及2026年1月9日的公告(「該等公告」)。

所得款項用途	所得款項 淨額 (百萬港元)	截至2026年 6月30日 止六個月 已動用款項 (百萬港元)	於2026年 6月30日 累計 已動用款項 (百萬港元)	剩餘款項 (百萬港元)	預期動用剩餘 所得款項淨額 時間線 (附註1及2) (百萬港元)
1. 招募新員工進行銷售及營銷以及業務發展，並升級倉庫設施	20.6	0.0	(20.6)	0.0	—
2. 為推廣電商平台、芯球計劃及新產品投放廣告及組織營銷活動	41.2	0.0	(41.2)	0.0	—
3. 升級、進一步發展及維護本集團的電商平台以及改良技術基礎設施	17.3	0.0	(17.3)	0.0	—
4. 用於研發	20.6	0.0	(20.6)	0.0	—
5. 為潛在收購或投資電商行業或電子行業的業務或公司撥資	61.7	0.0	(61.7)	0.0	—

所得款項用途	所得款項 淨額 (百萬港元)	截至2026年 6月30日 止六個月 已動用款項 (百萬港元)	於2026年 6月30日 累計 已動用款項 (百萬港元)	剩餘款項 (百萬港元)	預期動用剩餘 所得款項淨額 時間線 (附註1及2) (百萬港元)
6. 開發智能終端、邊緣運算及其他領域 的解決方案，以及投資於AI相關芯片 的分銷授權及市場推廣					
— 與銷售AI相關電子元器件有關 的銷售與經營費用	8.4	(8.4)	(8.4)	0.0	—
— 招募研發人員	15.5	(9.7)	(9.7)	5.8	預期於2028年 12月31日或 之前悉數動用
7. 一般營運資金	<u>20.5</u>	<u>0.0</u>	<u>(20.5)</u>	<u>0.0</u>	—
	<u>205.8</u>	<u>(18.1)</u>	<u>(200.0)</u>	<u>5.8</u>	

附註：

1. 預期動用剩餘所得款項淨額時間線按本公司最佳預測制定，當中考慮(其中包括)目前及日後市場狀況及業務發展及需要，因此可能會發生變動。
2. 於2025年12月17日，董事會已決議更改上市所得款項淨額23.9百萬港元的用途。有關詳情請參閱該等公告。

流動資金及財務資源

本集團的主要資金來源包括自其經營業務產生之現金及銀行授出的信貸融資。本集團擁有充足的現金及可用銀行融資以滿足其承擔及營運資金需求。

於2026年6月30日，本集團之受限制及未受限制銀行結餘及現金總額為454.2百萬港元(2025年12月31日：336.6百萬港元)。

於2026年6月30日，本集團之尚未償還銀行及其他借貸為1,270.6百萬港元(2025年12月31日：531.3百萬港元)。本集團之資本負債率(以計息借貸除以權益總額計算)由2025年12月31日的50.0%增加至於2026年6月30日的97.2%，原因是銀行借貸增加。

於2026年6月30日，本集團銀行融資(不包括備用信用證)總額及未動用金額分別為3,686.3百萬港元及1,675.5百萬港元(2025年12月31日：2,340.7百萬港元及1,809.4百萬港元)。

於2026年6月30日，本集團擁有流動資產3,450.3百萬港元(2025年12月31日：1,838.8百萬港元)及流動負債2,663.2百萬港元(2025年12月31日：1,172.7百萬港元)。於2026年6月30日的流動比率為1.30倍(2025年12月31日：1.57倍)。

截至2026年6月30日止六個月，本集團之貿易應收賬款週轉期為40日，而2025年同期則為57日。貿易應收賬款整體週轉期在信貸期內。

截至2026年6月30日止六個月的貿易應付賬款週轉期為23日，而2025年同期則為32日。貿易應付賬款週轉期維持合理水平。

截至2026年6月30日止六個月的存貨週轉期為19日，而2025年同期則為21日。存貨週轉期維持平穩水平。

外匯風險

本集團之交易主要以美元及人民幣計值。截至2026年6月30日止六個月，儘管匯率出現波動，本集團並無就其經營業務經歷任何重大困難或重大不利影響並錄得匯兌收益淨額約5.1百萬港元(截至2025年6月30日止六個月：匯兌虧損淨額約1.0百萬港元)。於本公告日期，本集團並無採納任何外幣對沖政策。然而，本集團將考慮使用外匯遠期合約降低重大外匯風險帶來的貨幣風險。

資產抵押

於2026年6月30日，透過損益按公平值列賬(「**透過損益按公平值列賬**」)之金融資產為130.5百萬港元(2025年12月31日：134.1百萬港元)及銀行存款288.6百萬港元(2025年12月31日：182.7百萬港元)已抵押作為本集團銀行借貸及融資安排的擔保。

資本承擔及或然負債

於2026年6月30日，本集團均無重大資本承擔及或然負債。

所持有的重大投資

除上文所披露透過損益按公平值列賬之金融資產及透過其他全面收入按公平值列賬的金融資產以及簡明綜合財務狀況表所述於聯營公司之投資外，本集團於截至2026年6月30日止六個月並無持有任何重大投資。

有關附屬公司及聯營公司的重大收購及出售事項

本集團於截至2026年6月30日止六個月並無進行有關附屬公司及聯營公司的重大收購或出售事項。

購買、出售或贖回上市證券

截至2026年6月30日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

2026年6月30日後事項

於2026年7月13日，本公司按每股股份3.00港元完成配售97,736,000股新股份，籌得所得款項淨額約291.3百萬港元。所得款項擬用於擴大本集團存儲芯片及光電器件的採購及庫存。

遵守企業管治守則

董事會承諾維持高水平的企業管治標準。董事會認為，透過採納有效的管理問責制度及高標準的商業道德來維持良好企業管治，有利於建立重要框架，以支撐本公司可持續發展及保障股東、供應商、客戶、員工及其他利益相關人士的利益。

本公司已採納上市規則附錄C1所載《企業管治守則》及《企業管治報告》（「**企業管治守則**」）之守則條文作為其企業管治守則。除本公告下文所披露之守則條文C.2.1外，本公司於截至2026年6月30日止六個月期間已遵守企業管治守則之適用守則條文。本公司之企業管治常規基於企業管治守則所載之原則、守則條文及若干建議最佳常規訂立。

根據企業管治守則的守則條文C.2.1，主席與行政總裁的角色應有所區分，並不應由同一人擔任。

本公司偏離守則條文C.2.1，因現時田衛東先生兼任主席及行政總裁。董事會相信，將主席與行政總裁的兩個職能集中於同一人士，可確保本集團內部領導的一致性，並讓本集團的整體策略規劃更有效且更高效。董事會認為，目前的安排將不會削弱權力制衡，而且將有助於本公司迅速及有效地作出及實行決策。經慮及本集團的整體狀況後，董事會將繼續檢討這個架構並考慮於適當時候將董事會主席與本公司行政總裁之職務分開。

證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)作為其自身董事進行證券交易的行為守則。本公司已向董事作出具體查詢，所有董事已確認於截至2026年6月30日止六個月期間彼等已全面遵守標準守則。

審核委員會

本公司已成立由三名獨立非執行董事(即湯明哲博士、許微女士及林晨博士)組成的審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務呈報流程及內部控制系統，並向董事會提供意見和建議。審核委員會已審閱本集團截至2026年6月30日止六個月之中期業績(「中期財務報表」)，並與外部核數師討論中期財務報表的獨立審閱結果以及與管理層討論本集團所採納之會計政策、本集團內部監控及財務申報事宜。

刊發中期業績

本公告已刊發於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.smart-core.com.hk)。本公司截至2026年6月30日止六個月之中期報告載有上市規則及其他適用法例及法規規定的全部資料，將於適當時候寄發予股東及刊發於聯交所及本公司網站。

承董事會命
芯智控股有限公司
董事長及執行董事
田衛東

香港，2026年8月25日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事田衛東先生(董事長)、劉紅兵先生、麥漢佳先生及鄭鋼先生，非執行董事黃梓良先生，獨立非執行董事湯明哲博士、許微女士及林晨博士。